

Micron presenta Mobile 3D NAND per smartphone di ultima generazione

La nuova tecnologia di memoria Micron Mobile 3D NAND da 32GB offre qualità, performance e affidabilità superiori che ottimizzano l'esperienza multimediale e di streaming di ultima generazione per dispositivi mobili

SANTA CLARA, California, 9 agosto 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Micron Technology, Inc., (Nasdaq:MU) ha presentato oggi la sua prima tecnologia di memoria 3D NAND ottimizzata per dispositivi mobili e i suoi primi prodotti basati sullo standard Universal Flash Storage (UFS) 2.1. La soluzione iniziale di Micron basata sulla tecnologia 3D NAND da 32GB ha come target specifico segmenti smartphone di fascia alta e intermedia, che rappresentano circa il 50% del volume degli smartphone a livello mondiale^[1]. Con i dispositivi mobili che stanno soppiantando i pc proponendosi come gli strumenti informatici di riferimento per i consumatori, i comportamenti dell'utente hanno un forte impatto sulla memoria mobile e sui requisiti di archiviazione dei dispositivi. La tecnologia mobile 3D NAND di Micron cerca di dare una risposta a queste criticità, migliorando nettamente l'esperienza degli utenti grazie a streaming HD perfettamente fluidi, una maggiore larghezza di banda per il gaming, tempi di avvio più rapidi, performance ottimizzate della telecamera e caricamento veloce dei file.

“Con l'introduzione di 3D NAND e delle soluzioni UFS di Micron continua a perfezionare la tecnologia NAND per il segmento mobile”, ha dichiarato Mike Rayfield, vice presidente della divisione mobile di Micron. “Le performance ottimizzate, la capacità e l'affidabilità superiore di 3D NAND aiuteranno i nostri clienti a soddisfare la crescente domanda di storage mobile, garantendo un'esperienza ancor più esaltante per l'utente finale.”

In risposta alla domanda per requisiti hardware superiori, che consentano di stare al passo con il vorace consumo di contenuti mobili video e multimediali, oltre che alla prevista crescita dei requisiti di storage che porterà l'introduzione di reti wireless 5G, la tecnologia 3D NAND di Micron impila strati di celle di storage di dati verticalmente con la massima precisione, dando vita a soluzioni di storage che triplicano la capacità rispetto alle tecnologie NAND planari della precedente generazione. Poiché la capacità è strettamente legata alla configurazione verticale delle celle, Micron è in grado di concentrare un maggior numero di celle di storage in un'area molto più piccola, dando vita in questo modo al più piccolo chip di memoria 3D NAND che misura solo 60,217 mm². Un chip più piccolo riduce lo spazio dedicato

alla memoria, liberando spazio per batterie più grandi o per dispositivi con un fattore di forma inferiore.

“La tecnologia 3D NAND sarà fondamentale per lo sviluppo di smartphone e altri dispositivi mobili”, secondo Greg Wong, fondatore e analista principale di Forward Insights. “Con l’avvento del 5G e il ruolo sempre più influente dei dispositivi mobili nelle nostre vite digitali, i produttori di smartphone hanno bisogno della tecnologia più avanzata per archiviare e gestire un volume di dati in continua crescita. La tecnologia 3D NAND per dispositivi mobili di Micron ha tutti i requisiti per rispondere alle esigenze di archiviazione dati in evoluzione, consentendo un’esperienza utente più fluida per contenuti video ad alta risoluzione, gaming e foto.”

3D NAND: nuova potenza per un panorama della mobilità in evoluzione

La prima memoria 3D NAND per dispositivi mobili di Micron offre svariati vantaggi tecnici rispetto alle soluzioni concorrenti. Di seguito elenchiamo alcune tra le nuove caratteristiche:

- prima soluzione mobile del settore basata sulla tecnologia Floating Gate, un sistema utilizzato universalmente e perfezionato negli anni con la produzione di memorie flash planari ad alto volume;
- primi dispositivi di memoria Micron basati sullo standard UFS 2.1 che garantiscono la miglior performance di lettura sequenziale del settore per il mercato mobile;
- pacchetti multichip 3D NAND-based (MCP), comprensivi di memorie LPDDR4X a basso consumo, che migliorano l’efficienza energetica del 20% rispetto alle tradizionali memorie LPDDR4;
- chip di memoria 3D NAND più piccolo del settore, che misura solo 60,217 mm² e permette di creare pacchetti dati minuscoli, ideali per dispositivi con fattori di forma molto piccoli; le dimensioni del chip 3D NAND di Micron sono più piccoli del 30% rispetto al chip planare NAND della stessa capacità.

Le soluzioni 3D NAND di Micron per dispositivi mobili sono al momento in fase di campionamento con clienti e partner di tecnologie mobili e saranno disponibili al pubblico alla fine del 2016.

[1] Fonte: Previsioni interne di Micron

Risorse aggiuntive:

- Per saperne di più sulle [soluzioni di memoria Micron per dispositivi mobili](#)
- Per saperne di più sui [prodotti 3D NAND di Micron](#)
- [3D NAND per scheda dati per dispositivi mobili](#)

Seguici online! Prendi parte alle conversazioni di Micron sui social media, dove parliamo di tutto ciò che riguarda lo storage e le memorie:

- Blog: www.micron.com/about/blogs
- Twitter: www.twitter.com/MicronTech
- LinkedIn: www.linkedin.com/company/micron-technology
- YouTube: www.youtube.com/microntechnology

Micron Technology, Inc.

Micron Technology, Inc. è leader mondiale nei sistemi di semiconduttori avanzati. L'ampio portafoglio di tecnologie di memoria ad alte prestazioni di Micron - tra cui DRAM, NAND e NOR Flash - è la base per le unità a stato solido, moduli, pacchetti multichip e altre soluzioni di sistema. Facendo leva su più di 35 anni di leadership tecnologica, le soluzioni di memoria di Micron consentono le soluzioni più innovative al mondo in ambito IT, consumer, enterprise storage, networking, applicazioni mobili, embedded e automobilistiche. Le azioni ordinarie Micron sono quotate al NASDAQ con il simbolo MU. Per ulteriori informazioni su Micron Technology, Inc., visitare www.micron.com.

Contatti per la stampa:
Sarah Lewis
Zeno Group for Micron Technology
650-801-0937
sarah.lewis@zenogroup.com